

EKOPRODUR DCP 2009

NAZWA CHEMICZNA	System poliuretanowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	<p>Wagowy stosunek komponentów POY : ISO 100 : 130</p> <p>Temperatura komponentów:.....18 – 22°C</p> <p>Temperatura otoczenia:.....15 – 25°C</p> <p>Temperatura okładzin / form:30 – 40°C</p> <p>System poliuretanowy EKOPRODUR DCP 2009 może być przetwarzany przy pomocy nisko- i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Pełne własności mechaniczne pianka uzyskuje po sezonowaniu trwającym 24 godziny. Przy przetwarzaniu systemu należy uwzględnić wskazówki i informacje zawarte w Kartach Charakterystyk obu składników.</p>
DANE INFORMACYJNE	<p>Klasyfikacja ogniowa.....F PN-EN 13501-1+A1:2010</p> <p>Współczynnik przewodności cieplnej: $\lambda_{mean, i}$ 0,022 W/(m·K) PN-EN 12667:2002</p> <p>Przyczepność pianki prostopadle do podłoża.....≥ 280 kPa PN-EN 1607:2013-07</p> <p>Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, równoległe: $\sigma_{10} \geq 330$ kPa PN-EN 826:2013-07</p> <p>Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, prostopadle: $\sigma_{10} \geq 240$ kPa PN-EN 826:2013-07</p> <p>Stabilność temperaturowa:</p> <p>+ 70°C, 90% RH, po 24h g +0,3 % d +0,3 % sz +1,6 %</p> <p>-30°C, po 24h g 0,0 % d 0,0 % sz -0,2 % PN-EN 1605:2013-07</p>
ZASTOSOWANIE	EKOPRODUR DCP 2009 stosuje się do izolacji urządzeń chłodniczych oraz produkcji płyt i paneli izolacyjnych w formach.